

: ; < =

> ? @ 2012 A 10 B 24 >

华润微电子荣膺“中国十强半导体企业”称号 于 IC China 2012 精彩亮相举办首场制造服务研讨会

C 2012 A 10 B 23 > D E IC China 2012 F G H I J K L ! " # \$ % & ' (M E ! " # \$ F N O P Q R S T U V W X Y Z A E Q R Z [S T U \ W F] ^ _ ` a Q R S T U b c d e f E Z g h F Q R S T U V W D X Y i j k D Q R S T U V W X Y Z A l m n o p q _

r s IC China L ! " # \$ t u v w L x C 10 B 23-25 > ? y z { Y | } ~ L • 于 10 B 24 > , 午 C 2 c 现场举 k 了 q 场主题 d E 多方位 V W 链服务 d IC z 计增值 F D ! " # \$ 制造服务研讨 c _ ` 场研讨 c 由 Q S b 主办 L 由 ! " # \$ 携 + , 掩模、晶圆代工、封装、测试 D W 务单位—— ! 掩膜、 ! K 、 ! 安盛、 ! 赛美科承办 L 旨 C Y 示 ! " # \$ 特 % D 制造与代工服务优势 L } 及 b 助终端客户完善应用方案 D 能力 _ 研讨 c 现场来宾共计近 250 位 L 均来自 R 内 IC z 计 ' (、功率器件厂商、分销商、应用方案 ' (_

研讨 c K L ! " # \$ * 队分别作了 E ! " # \$ 多方位 V W 链服务 F、E 助力 IC z 计快速制版 D 激光工艺服务 F、E 根植 Q R 热点市场应用 D 特色模拟晶圆制造服务 F、E G 性价 D 封装 F、E 应用于 G 模拟 V 测试 D 激光 F、E X Y Q D 色能 S T U 应用 方案 F L V W D X Y ! " # \$ 掩模、晶圆代工、封装、测试 D W 务特色分别作了 D _ ! " # \$ D 掩模、晶圆代工、封装、测试服务 * 队 • 与来宾 j k 了 D L d IC z 计 ' (方位了 ' (多方位 V W 链增值服务了 q D | _

! " # \$ v 研讨 c 5 L l 示 !) * c X Y " # \$ V W D L ' (d t 率 L 能 C k w Q 与 共 L C 来 D W 务 X Y Q ? 作 L ! " # \$ 与客户、 应商 < 作能 L ` a k w \ W 2 [D 根 _ ! " # \$ k d 研讨 c l 示 L C S T U 市场 r 激 D 烈今 L 热点天丰 i 富 2 D Q R S T U 市场巨依 % 80% } K D IC 巨然 j 赖 D 口势 L 作 d 形 \ L ! " # \$ 央感 了 [D 受力 压使央 _ ' (命战方略向聚 C 色 能 S T U 焦领 L 域用自利 C V W 链 K D 优势 L } 及 Q R 应用市场 D 身 L 力理 d Q R S T U V W、d Q R 客户 求最 客户符需、市场需理 D 服务 _ 来宾 < 要研讨 c L 了 能 ! " # \$ D V W 链服务 Q 次 得哪 % 价值 D 些支 L ? 持 2 待携家手再 Q R S T U V W X Y D : 写篇 _

Q R S T U k w b c k 章身 副徐小 d 研讨 c L l 示 L ! " # \$ a 2 田陆建 D



求立 性D综历求史悠DSTU\WL久 担 " # \$ VWXYDt2 L` aW
内着人共 D L d2待因 Da 所息化基VWL础及涉cD方方 L社包着
D 括 居L因} `活需理\W能 就具涉c 央L备不需 V 研XL C需
仅身、管幸\W福工作L7等承久 涉cD _bc 正非常于dW内\W
D服务Ld乐 戡 DSTUVWDXY备 力 余奋Ld f涉cDXY作v 力_ 们

v c D • % Q STUkWbc特 章身 、 QRSTUkWbc
、 QRSTUkWbc章身 /QR科 " # \$研 因因 、 K 市) #
kWbc 、 IHS iSuppliSTU 分 L } 及 ! " # \$ D多待V
W链 作 _多待kW U 场 _

关于华润微电子

! " # \$ % & ' (a !) * + , " # \$ W务 、 XY 仅身DG科 \WL aQR
模 力求2D立 性" # \$ \WpqL 9A R待工W 所息 dQR# \$ 所 [
\Wpq _ ' (} " # \$ VWd L dQR 求就 力DSTU' (_ ' (dQ
R内 焦 D模拟STU' (L W务社包 晶圆代工、) # z计、) # 测试封装及分建
器件_ % 5-8 晶圆 V 5 LAV晶圆 370 LaR内造TUVW链求d D\W _

! " # \$ 建于2000 AL2002A R内求2D " # \$ \W 晶) * L d ! + , " # \$ W务
、 XY 仅身D\WL 于2003A f6 晶圆 V 陆zno 于2006A与: STATS
ChipPAC 作XY) # 封测W务 于2007A f8 晶圆 V 陆znoL 于2009A VL
aR内 q巨 自% 、 市场陆建D求G D晶圆 V 2011A E v F命
战Lz建| / 赖' (LC美R z建) # z计' (_

传媒垂询:

华润微电子有限公司

5 @ (+86-510) 8580 7123-2716

家 @ (+86) 1586 1580 806

6 7 @ (+86-510) 8580 4647

\$ @ wudn@crmicro.com

5 @ (+86-510) 8811 5604

家 @ (+86) 1396 1855 032

6 7 @ (+86-510) 8811 5555 ext.5604

\$ @ jiangy@csmc.crmicro.com

! " # \$ % & ' (China Resources Microelectronics Limited !) * + , ' (
- . / 0 . / 1 ! 2 3 4609-4610 4 Room 4609-4610, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
5 Tel (852) 2299 9188 6 7 Fax (852) 2299 9300 8 9 Website: www.crmicro.com